



## MSL FPGA INC 晶片參數

### ■ 芯片概述

TE0803-04-5DE11-A是来自MSL FPGA INC美时龙的一款基于Zynq UltraScale+ MPSoC的高性能模块化开发板，以下是其关键信息：

### ■ 核心参数

工作温度范围：支持-40至85的宽温域工作，适应工业级环境需求。

输入耐压：具备36V高输入耐压能力，BAT管脚耐压达20V，并集成防反接功能。

充电电流：最大支持1A充电电流，可通过外部电阻灵活调节。

### ■ 功能特性

充电管理：支持涓流、恒流、恒压三阶段充电，集成温度监控和自动电流调节功能，防止过热损坏。

安全保护：内置过压保护（OVP）、欠压保护（UVLO）、短路保护及充电超时保护，提升系统可靠性。

低功耗设计：优化电源路径管理，降低静态功耗，适合电池供电设备。

### ■ 应用场景

便携设备：如智能手表、蓝牙耳机等需高效充电管理的消费电子产品。

工业工具：适用于电动工具、手持设备等对耐压和温度稳定性要求较高的场景。

家电产品：集成于小型家电的电源管理模块，简化电路设计并提升安全性。